

Page 1 of 5

新闻稿

实时发布

科技园公司与产品可靠性暨系统安全研发中心 (CAiRS) 携手推动新型工业化 加速本地微电子及先进制造业初创发展

双方合作协助初创突破瓶颈 进行微电子业关键测试及量产程序

- 科技园公司与产品可靠性暨系统安全研发中心 (CAiRS) 签署合作协议，进一步支援微电子初创进行测试及量产。
- 签约仪式在 IEEE Reliability Society 香港分会成立典礼上进行。该会致力促进香港产品可靠性及安全性的创新发展，是本地创科生态圈的重要一环。
- 这次合作范畴为第三代半导体和 3D 系统级封装 (3D SiP)，第三代半导体用途广泛，包括电动车、5G 技术，以及香港和大湾区的智慧制造和运输。

(香港，2023 年 9 月 28 日) — 香港科技园公司 (科技园公司) 与香港理工大学 (理大) 及美国马里兰大学于 InnoHK 创新香港研发平台设立的「产品可靠性暨系统安全研发中心」(CAiRS) 签署合作协议，共同协助微电子及先进制造业初创提升必要测试及量产的能力。

签约仪式在早前举行的 IEEE Reliability Society 香港分会成立典礼上进行。IEEE Reliability Society 香港分会是本地创科生态圈的重要一环，致力促进香港产品可靠性及安全性的创新发展。成立典礼及签约仪式的主礼嘉宾包括香港特别行政区创新科技及工业局副局长张曼莉女士、香港科技园公司行政总裁黄克强先生、IEEE 香港分会主席、香港大学电机电子工程系主任黄建业教授，以及香港理工大学常务及学务副校长黄永德教授等。

科技园公司的异构系统整合实验室 (HI Lab)，专门为第三代半导体及 3D 系统级封装 (3D SiP) 技术而设，为微电子初创提供大规模测试其产品及技术的能力及资源，以完善由端到端开发到生产的整个行业价值链。与 CAiRS 的合作可以进一步强化 HI Lab 的支持能力，透过协助微电子业初创突破瓶颈，大幅推动行业创新发展，改善产品安全性与可靠性，提高不同阶段初创的市场潜力及微电子业整体水平，以实现香港新型工业化的发展目标。

香港特别行政区创新科技及工业局副局长张曼莉女士表示：「我很高兴出席 IEEE Reliability Society 香港分会成立典礼暨香港科技园公司与产品可靠性暨系统安全研发中心 (CAiRS) 的合

Page 2 of 5

作协议签署仪式，这个合作正好配合特区政府去年 12 月公布的《香港创新科技发展蓝图》的愿景和使命。香港有着雄厚的科研实力及追求突破的精神，特区政府将继续促进上中下游的合作以及推动创新科技产业发展，并进一步加强及发挥香港背靠祖国、联通世界的独特优势。我期待 IEEE Reliability Society 和 CAiRS 的合作带来的突破，为我们创新科技的发展塑造美好未来。」

香港科技园公司行政总裁黄克强先生表示：「是次与 CAiRS 的合作，是科技园公司打造完善科创生态圈工作上再一步向前迈进的里程碑。从研发、全面产品发展、前期测试，以至正式将产品推出市场，科技园公司于每个阶段均能为微电子初创提供適切支持。配合为微电子及先进制造业而设的专门设备及创新园内的完善设施，我们致力将香港打造成全球电子和工程枢纽，吸引相关专才，同时协助微电子初创和相关公司扩展业务，打进国际市场。」

香港理工大学常务及学务副校长黄永德教授表示：「理大全力支持 IEEE Reliability Society 香港分会的成立以及香港科技园公司与产品可靠性暨系统安全研发中心的合作协议。这次在第三代半导体和三维系统封装方面的合作将有助于释放第三代半导体的巨大潜力，这些半导体可用于电动车、5G 技术以及香港和大湾区的智能制造和运输。」

CAiRS 是 InnoHK 创新香港研发平台的研发实验室，是专注研究产品可靠性及安全创新的领先枢纽。科技园公司的 HI Lab 配置了一套异构系统及先进封装平台，可进行微电子原型的小批测试。

科技园公司与 CAiRS 的合作，会为微电子初创提供培训课程和咨询服务，并会探讨共同进行第三代半导体和传感器产品可靠性和失效分析项目机会。这些项目的成果将用作推动新型工业化发展及智慧城市的应用，藉由香港在电子业及制造业的世界级优势，抓紧微电子日益增长的全局机遇。

如欲了解更多有关科技园公司 HI Lab，请浏览 <https://www.hkstp.org/zh-hk/what-we-offer/infrastructure/heterogeneous-integration-lab/>。



图一：（由左至右）CAiRS 总监及执行董事容锦泉教授工程师、香港理工大学常务及学务副校长黄永德教授、香港特别行政区创新科技及工业局副局长张曼莉女士、香港科学园公司行政总裁黄克强先生、IEEE Reliability Society 香港分部主席、香港大学电机电子工程系主任黄建业教授，以及投资推广署创新及科技行业主管黄炜卓先生出席及见证 IEEE Reliability Society 香港分会之成立典礼。



图二：香港科技园公司首席企业发展总监姚庆良博士工程师（左二）与 CAiRS 总监及执行董事容锦泉教授工程师签订合作协议。香港科技园公司业务发展总监黄家裕（左一）及香港理工大学工程学院院长文効忠教授工程师（右一）担任见证人。



Page 4 of 5



图三：IEEE Reliability Society 香港分会的成立旨在促进香港在产品可靠性及安全性科技的发展，是本地创科生态圈的重要一环。



图四：科技园公司与 CAIRS 的合作将藉由香港在电子业及制造业的世界级优势，抓紧微电子日益增长的全球机遇。

###

Page 5 of 5

关于香港科技园公司

香港科技园公司（科技园公司）成立逾 20 年，致力将香港发展成为国际创新科技中心，积极让本地及全球创新者迈向成功，帮助他们在未来获得更大成就。科技园公司在香港建立了蓬勃的创科生态圈，过去共支持超过 10 间独角兽企业，亦汇聚超过 13,000 名研究人才，以及超过 1,400 间从事生物医药技术、人工智能及机械人技术、金融科技及智慧城市发展的科技公司。

科技园公司于 2001 年成立，一直大力吸纳及孕育创科人才、加速创科成果商品化，为创业家的创科路上提供全方位支持。我们建立的创科生态圈持续成长，足迹遍及全港，包括沙田的香港科学园、九龙塘的创新中心，以及位于大埔、将军澳及元朗的创新园。三个创新园结合创新元素，朝着香港新型工业化发展方向，重点带动先进制造业、微电子业及生物科技等行业，重新定位新世代工业。

科技园公司透过提供基础设施、支持服务、专业知识及合作伙伴网络，致力令创新科技成为香港的新经济动力，巩固香港国际创新科技中心的地位，同时借助位处大湾区核心的优势，成为引领创科发展的重要引擎。

更多有关香港科技园公司的详情，请浏览 www.hkstp.org。

传媒查询，请联络：

香港科技园公司

马碧茹

电话：+852 2629 7032

电邮：claire.ma@hkstp.org

爱德曼国际公关公司

梁爽爽

电话：+852 2837 4775 / 9684 9460

电 邮： Sonia.Leung@edelman.com /
Edelmanhkstppr@edelman.com